

NITOFLON™ モールド用離型フィルム

MPS シリーズ

概 要

NITOFLON™(ニトフロン) MPS シリーズは、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)をフィルム化した製品であり、耐熱性、離型性、柔軟性に優れます。

半導体チップの樹脂封止工程などで離型フィルムとして使用することで、金型清掃頻度の低減、溶剤使用量の低減、金型の長寿命化といった効果が期待されます。

構 成



図.1 構成図

特 長

- -100℃から 260℃までの連続使用が可能であり(推奨値)、短時間ならより高温でも使用可能です。
- 離型性(非粘着性)にすぐれ、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。
- 加熱による伸縮特性を変えた品番(縦収縮、横収縮等)をラインナップしています。

用 途

- 半導体チップの樹脂封止工程用離型フィルム

特 性

表 1 一般特性

項目	単位	MPS-10	MPS-11	MPS-13
厚さ	mm	0.05	0.05	0.05
引張強度	MPa	50	58	79
伸び	%	300	258	120
加熱収縮率 (175℃×30分)	MD	%	3.5	1.8
	TD		-1.5	-0.7
表面粗さ (Ra)	μm	0.27	0.20	0.24/0.36
離型性 (NO.31B 法)	N/19mm	0.9	0.8	0.8
融点[連続使用温度]	℃	327 [260]		
特徴	-	標準	低線膨張	高強度 高熱収縮

使用上の注意事項

- 製品を廃棄する場合は、該当地域の規則に従って廃棄してください。焼却処理する場合は有害なフッ素ガスが発生しますので適切な処理装置を使用してください。
- フッ素ガスが発生する場合がありますので、400℃以上の加熱はおやめ下さい。
- 本製品は工業用製品です。人体には使用しないで下さい。
- 保管する場合は直射日光を避け涼しい場所においてください。